

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2013-044

浙江晶盛机电股份有限公司 关于研发项目取得重大技术进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日我公司和国内最大、世界第三的区熔硅单晶生产企业——天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“天津环欧”）联合承担并由我公司研制的国家科技重大专项《区熔硅单晶片产业化技术与国产设备研制》之“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题的区熔硅单晶炉，在天津环欧应用现场，结合天津环欧领先水平的晶体生长工艺技术并经其工艺人员验证，成功拉出8英寸气相掺杂单晶硅。单晶棒长度约800mm，直径202.5mm，重量约47.7kg，单晶轴向电阻率 $35\sim 45\Omega\cdot\text{cm}$ ，径向电阻率不均匀度 $\text{RRV}<15\%$ ，单晶各项技术指标均已达到国际领先水平。采用气相掺杂技术拉制的区熔硅单晶解决了中子辐照单晶硅生产周期长、成本高、及晶体中照损伤的不利因素。

8英寸气掺区熔硅单晶棒的拉制成功，验证了我国自主研发的区熔硅单晶炉技术已取得了突破性的进展，也是目前国产区熔设备上拉制出的尺寸最大的气掺区熔单晶棒。相比于传统的中子照射区熔硅单晶棒，气掺区熔硅单晶棒可降低生产成本20%~30%，在IGBT大功率器件领域具有非常好的应用前景。

此项重大进展表明我公司的8英寸区熔硅单晶炉已具备产业化基础，并预计将在2013年开始实现少量销售。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司董事会

2013年6月3日